



平成 16 年 10 月 20 日

各 位

上場会社名 メ ッ ク 株 式 会 社
 (コード番号: 4971 東証第2部・大証ヘラクレス)
 本社所在地 兵庫県尼崎市昭和通3丁目95番地
 問合せ先 社長室長 坂本 佳宏
 TEL 06-6414-3451

平成 17 年 3 月期業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績の動向等を踏まえ、平成 16 年 5 月 13 日の決算発表時に公表いたしました平成 17 年 3 月期(平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日)の中間および通期の業績予想(連結・単体とも)を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。なお、平成 17 年 3 月期中間決算は 11 月 9 日(火曜日)を予定しております。

記

1. 平成 17 年 3 月期中間業績見込み数値の修正(平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 9 月 30 日)

(1) 連結中間業績見込み

(単位: 百万円、%)

	売上高	営業利益	経常利益	当中間期純利益
前回発表予想 (A)	2,963	531	504	340
中間業績見込み (B)	3,025	535	555	358
増減額 (B-A)	62	4	50	18
増減率	2.1	0.8	10.0	5.3
前年同期実績 (C)	2,936	463	413	247
前年同期比((B/C) × 100)	103.0	115.7	134.2	144.7

(2) 単体中間業績見込み

(単位: 百万円、%)

	売上高	営業利益	経常利益	当中間期純利益
前回発表予想 (A)	2,214	277	246	159
中間業績見込み (B)	2,298	248	305	209
増減額 (B-A)	83	28	59	49
増減率	3.8	10.4	24.1	31.2
前年同期実績 (C)	2,225	279	220	100
前年同期比((B/C) × 100)	103.3	89.0	138.2	207.6

2. 平成 17 年 3 月期連結業績予想数値の修正(平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日)

(1) 連結業績予想

(単位：百万円、%)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想 (A)	6,194	1,191	1,141	755
今回修正予想 (B)	6,046	1,064	1,066	696
増減額 (B-A)	148	126	74	58
増減率	2.4	10.6	6.5	7.8
前期実績 (C)	5,848	1,053	946	588
前期比 ((B/C) × 100)	103.4	101.1	112.7	118.2

(注) 1 株当たり予想当期純利益は 68 円 36 銭になります。

(2) 単体業績予想

(単位：百万円、%)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想 (A)	4,586	639	621	398
今回修正予想 (B)	4,550	532	625	418
増減額 (B-A)	35	106	3	19
増減率	0.8	16.7	0.6	4.9
前期実績 (C)	4,490	610	550	291
前期比 ((B/C) × 100)	101.3	87.2	113.7	143.6

3. 修正の理由

(1) 中間業績見込みについて

売上高はほぼ予想通りで連結は 30 億 25 百万円(当初予想比 2.1%増、前年同期比 3.0%増)、単体売上高は 22 億 98 百万円(当初予想比 3.8%増、前年同期比 3.3%増)となる見込みであります。

営業利益は、当初予想に対し連結は 4 百万円増の 5 億 35 百万円(当初予想比 0.8%増、前年同期比 15.7%増)で、単体は 28 百万円減の 2 億 48 百万円(当初予想比 10.4%減、前年同期比 11.0%減)となる見込みであります。この理由は、薬品販売量増加による運賃およびアジア地域へ顧客の技術支援や、新設子会社のフォローなどによる旅費交通費が増加し、販売費及び一般管理費が予算を上回ったためであります。

経常利益は、当初予想に対し連結は 50 百万円増の 5 億 55 百万円(当初予想比 10.0%増、前年同期比 34.2%増)で、単体は 59 百万円増の 3 億 5 百万円(当初予想比 24.1%増、前年同期比 38.2%増)となる見込みであります。

中間純利益は、連結が 18 百万円増の 3 億 58 百万円(当初予想比 5.3%増、前年同期比 44.7%増)となる見込みであります。単体は 49 百万円増の 2 億 9 百万円(当初予想比 31.2%増、前年同期比 107.6%増)となる見込みであります。

単体の経常利益および純利益の増加は主に為替差益の発生によるものであります。

(2) 通期業績予想の修正について

通期業績予想に関しては、中間業績の見込みに基づき、今後の電子基板市場動向を加味し修正いたしました。

4. 当社を取り巻く環境に関して

当社は電子基板^{*1)}製造用の資材メーカーとして国内はもとより積極的に海外へ進出し事業の拡大を図っております。平成17年3月期(平成16年4月1日から平成17年3月31日)の電子基板市場は、プラズマ・液晶テレビ、DVDレコーダー等のデジタル家電や車のエレクトロニクス化に伴い拡大しております。

しかしながら、7月のオリンピック開催前後から、デジタルカメラ、一部の携帯電話向けの電子部品等に減速感が出ております。

また、電子基板の世界的製造拠点となりつつある中国の影響と電子部品等の価格下落に伴い、日本国内においても電子基板に対する価格引下げ圧力は以前にも増して強くなっております。

このような状況の下で、当社は銅表面処理剤^{*2)}を重点とし製品開発と販売に注力しております。品種別売上に関しては、主力製品であるCZシリーズ^{*3)}を含む銅表面処理剤が順調に売上拡大をしておりますが、メタルレジスト剥離剤^{*4)}とフラックス剤^{*5)}は使用工程の縮小により減少傾向であります。防錆剤^{*6)}は他社との競合が激しく、苦戦を強いられております。

また、顧客からの値下げ要請が例年以上に厳しくなっていることや販売量拡大による運賃の増加が営業利益を圧迫する要因となりました。

新製品に関しては、ポリイミドベース基板^{*7)}向けのCHシリーズ^{*8)}や多層電子基板^{*9)}向けのBOシリーズ^{*10)}、高密度電子基板^{*11)}向けのHEシリーズ^{*12)}など各種取り揃え積極的な販売活動を続けております。その結果、多数のお客様での採用が決定し、現在量産試験段階となっております。

このように当社を取り巻く環境は、価格競争の厳しさはあるものの市場拡大は続いております。当社は時代のニーズにあった多くの新製品を開発し、市場へ投入することで、事業拡大を図る所存であります。

* (業績等の予想に関する注意事項) *

この資料に記載されております業績等の予想数字におきましては、現時点で得られた情報に基づいて算出しておりますが、実際の業績は、今後の当社を取り巻く市場の経済情勢等の要因により本資料に記載されている予想とは異なる場合があることをご承知ください。

以上

用語説明

1) 電子基板

電子基板は、プリント配線板とも呼ばれ、携帯電話やコンピューター、テレビ等全てのエレクトロニクス機器の中にあり、主に緑色をしている板状のもの。LSI や抵抗、ダイオード等の電子部品をはんだで電子基板上に固定し、電気的な接続で電子回路として機能する重要な部品。

2) 銅表面処理剤

銅表面処理剤は、電子基板の配線パターンに用いられる銅の表面を処理し、適切な表面状態にする薬剤。電子基板製造は多数の工程が必要で、銅表面処理剤はそれぞれの工程で幅広く使われる。

3) CZ シリーズ

CZ シリーズはメックの銅表面処理剤の1つの商品名。CZ シリーズで処理した銅表面には超微細な凸凹形状となり、その表面に樹脂を貼り付けると高い密着力を示す。高い技術の要する電子基板製造に広く使われている。

4) メタルレジスト剥離剤

メタルレジスト剥離剤はハンダのみ溶解し、銅のアタックは殆ど無い薬剤。電子基板の配線パターン作成の1つとして、銅を保護するため、配線パターン上にハンダをつける工法がある。配線パターン作成後にこのハンダを除去するため使用される。

5) フラックス剤

フラックス剤は銅の表面にハンダを付ける際に用いる薬剤。電子基板メーカーが納入する際に露出している銅の表面を錆びや汚れから保護するためフラックス剤を用いてハンダを塗布する工法に使用される。

6) 防錆剤

防錆剤はフラックス剤と同様に銅の表面を錆びや汚れから守る薬剤。防錆剤は銅の表面に薄い有機皮膜を形成し、銅の表面を保護する。

7) ポリイミドベース基板

ポリイミドを絶縁樹脂に用いる電子基板の総称。フレキシ基板やCOF(Chip On Film)などがあり、携帯電話やPDPなどに用いられるため市場が急拡大している。

8) CH シリーズ

CH はニッケルクロム合金のみを溶解し、銅は殆どアタックしない薬剤。近年、ポリイミドベース基板の高密度化を実現するため、ポリイミド樹脂の表面にニッケルクロム層をつけ、その上に銅をつけたのち配線パターンを作成する工法があり、CH は残存したニッケルクロムを除去するのに使用される。

9) 多層電子基板

多層電子基板は、何層もの配線パターンを内側に有している電子基板のこと。デスクトップパソコンやブラウン管テレビ、DVD レコーダーなど電子機器に広く用いられている。電子基板の中に占める生産量は非常に大きい。

10) BO シリーズ

BO は多層電子基板製造に使用される銅表面処理剤。多層電子基板はそれぞれの層の配線パターンを作成し、一括プレスで製造されるが、その前処理剤として銅と樹脂との密着を向上させるために使用される。

11) 高密度電子基板

高密度電子基板は明確な定義付けは無いが、携帯電話やパソコンのMPU パッケージ、PDP、液晶テレビなどに使われる配線パターン幅が100 μm 以下の基板を指す。

12) HE シリーズ

HE は銅を溶解し膜厚を均一に薄くする薬品。銅箔の厚みは18 μm が一般的であるが、配線パターン幅を小さくするため更に薄い銅箔を作成するために使用される。